

Snapdragon 700 : Qualcomm comble l'espace entre les gammes 600 et 800

Cristiano Amon, président de Qualcomm, a profité du Mobile World Congress (MWC) 2018 afin d'annoncer la nouvelle gamme de puces mobiles Snapdragon 700.

Il s'agit de combler l'espace qui sépare les puces des gammes Snapdragon 600 (entrée / milieu de gamme) et 800 (haut de gamme).

Cette dernière a largement été à l'honneur durant le MWC grâce à l'annonce des flagships [Samsung Galaxy S9 et S9+](#), [Sony Xperia XZ2](#) et [Asus ZenFone 5Z](#) qui ont tous pour dénominateur commun le Snapdragon 845 (les S9 et S9+ en sont équipés pour le marché nord-américain).

Le fabricant de puces précise que la série Snapdragon 700 permettra d'augmenter d'un facteur 2 les performances IA en mode edge computing (exécution en local) et d'accroître de 30 % l'efficacité énergétique par rapport au SoC Snapdragon 660.

De plus, les puces de cette gamme supporteront la recharge rapide Qualcomm Quick Charge 4+, à l'instar du Snapdragon 845. De quoi permettre aux smartphones qui en seront équipées d'être rechargés de 0 à 50 % en l'espace de seulement 15 minutes.

Concrètement, Qualcomm veut rendre accessible, avec les puces plus abordables de la série 700, certaines des fonctionnalités de puces haut de gamme, telles que le Snapdragon 845.

«La plate-forme mobile Snapdragon 700 apportera des technologies et des fonctionnalités haut de gamme dans des appareils plus abordables, ce que nos clients et consommateurs OEM mondiaux exigent», a déclaré Alex Katouzian, vice-président et directeur général, mobile au sein de Qualcomm Technologies. «De notre moteur Qualcomm IA à la fine pointe de la technologie, à la performance et à la puissance des appareils, la série Snapdragon 700 est optimisée pour répondre aux attentes des utilisateurs des appareils mobiles les plus avancés à un prix inférieur. »

Pour assurer des performances supérieures au Snapdragon 660, les SoC bénéficieront d'une nouvelle mouture de coeur de processeur Kryo. Ces puces supporteront aussi le Bluetooth 5 et seront équipés de modems 4G LTE plus véloces (que pour la série 600).

Si les spécifications précises n'ont pas été dévoilées par la firme californienne, on sait par ailleurs que l'ISP (Image Signal Processor) sera amélioré.

Des échantillons commerciaux des premières plates-formes mobiles de la série Snapdragon 700 devraient être livrés aux clients dès le premier semestre 2018.

Qualcomm veille au grain sur le marché des puces mobiles et entend rivaliser avec MediaTek qui a présenté le [SoC Helio P60](#), lui-même équipé d'une unité dédiée au traitement des tâches IA en local.

(Crédit photo : @Qualcomm)